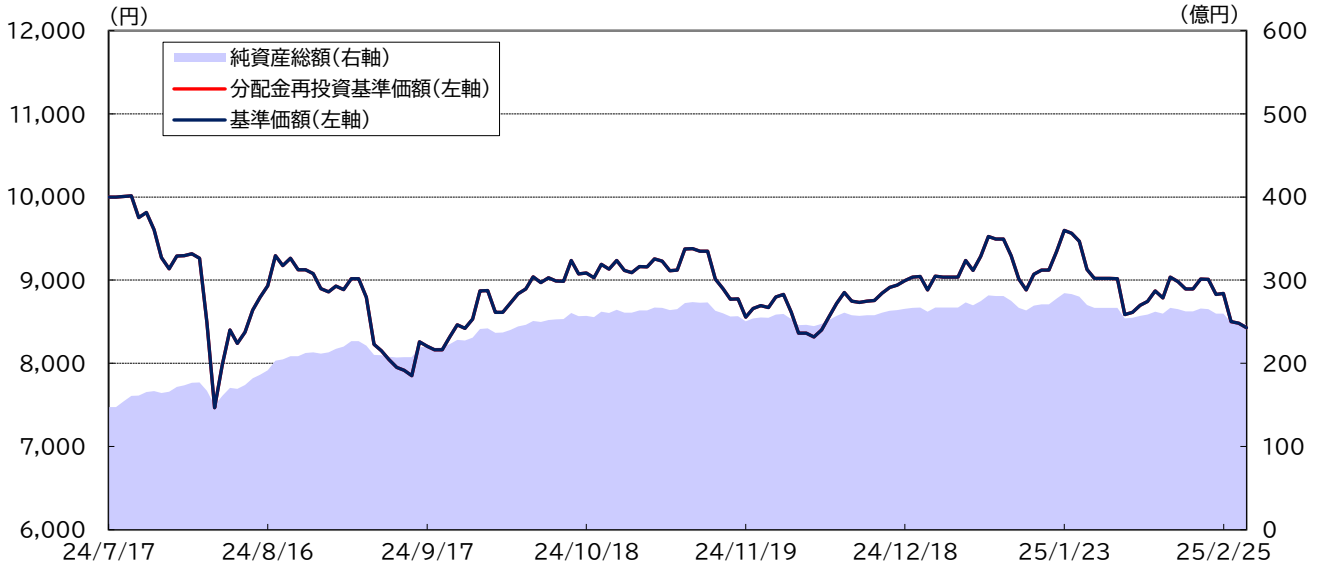
アジア半導体関連フォーカスファンド　愛称　ライジング・セミコン・アジア
追加型投信／内外／株式

設定来の基準価額の推移



※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後です。当ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象ファンドの信託報酬を間接的にご負担いただくことになりますので、作成基準日現在、純資産総額に年率1.9425%程度を乗じて得た額となります。
※分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

基準価額	8,428 円
純資産総額	246.9 億円

※基準価額は1万口当たりです。

騰落率

	1ヵ月前	3ヵ月前	6ヵ月前	1年前	3年前	設定来
分配金再投資基準価額	▲ 6.55%	0.79%	▲ 5.16%	－	－	▲ 15.72%
参考指数	▲ 0.43%	3.38%	6.74%	－	－	▲ 3.37%

※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。
※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。
※参考指数は、MSCI オール・カントリー・アジア・インデックス（米ドル建て、配当込み）〔円換算後〕です。
※参考指数の騰落率は、Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメントが算出しております。
※参考指数は、当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて算出しております。
※MSCI指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

最近5期の分配金の推移

2025/01/17	0 円
設定来合計	0 円

※分配金は1万口当たり、税引前です。運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

ポートフォリオ構成比率

Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）	97.7%
マネー・リクイディティ・マザーファンド	0.2%
短期金融商品・その他	2.1%

※構成比率は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

アジア半導体関連フォーカスファンド　愛称　ライジング・セミコン・アジア
追加型投信／内外／株式

Next Generation Semiconductor Asia Fund(円建て、ヘッジなしクラス)の状況(1)

国・地域別組入比率(上位10)

	国・地域	比率
1	台湾	47.4%
2	日本	35.4%
3	韓国	7.9%
4	マレーシア	4.6%
5	ケイマン諸島	1.7%
6	—	-
7	—	-
8	—	-
9	—	-
10	—	-

通貨別組入比率(上位10)

	通貨	比率
1	台湾ドル	47.4%
2	日本円	35.4%
3	韓国ウォン	7.9%
4	マレーシア・リンギット	4.6%
5	米ドル	1.7%
6	—	-
7	—	-
8	—	-
9	—	-
10	—	-

業種別組入比率(上位10)

	業種	比率
1	情報技術	70.3%
2	資本財・サービス	20.1%
3	素材	4.1%
4	一般消費財・サービス	2.4%
5	—	-
6	—	-
7	—	-
8	—	-
9	—	-
10	—	-

企業規模(株式時価総額)別構成比率

企業規模	比率
大型株 (200億米ドル以上)	22.6%
中型株 (50億米ドル超-200億米ドル未満)	25.3%
小型株 (50億米ドル以下)	49.0%

※株式時価総額の区分は、本資料独自のものであり、将来変更される場合があります。

※各比率は、「Next Generation Semiconductor Asia Fund(円建て、ヘッジなしクラス)」の純資産総額に対する比率です。
※各比率は小数点第2位を四捨五入しています。
※ニューバーガー・バーマンのデータを基にSBI岡三アセットマネジメントが作成しております。

アジア半導体関連フォーカスファンド　愛称　ライジング・セミコン・アジア
追加型投信／内外／株式

Next Generation Semiconductor Asia Fund(円建て、ヘッジなしクラス)の状況(2)

組入上位10銘柄　（組入銘柄数: 51）

	銘柄名	業種	国・地域	比率	銘柄概要
1	メディアテック	情報技術	台湾	5.0%	台湾の半導体メーカー。スマートフォンやIoT機器など、幅広い用途向けにSoC(システム・オン・チップ)を提供。
2	台湾セミコンダクター(TSMC)	情報技術	台湾	4.2%	台湾の半導体受託製造専業企業。スマートフォンやデータセンター向け最先端半導体の受託製造に強み。
3	グローバル・ユニチップ	情報技術	台湾	4.1%	台湾の半導体企業。特定の機器や用途のために設計するASIC(カスタムIC)に強みを持つ。
4	ASメディア・テクノロジー	情報技術	台湾	3.8%	台湾の半導体メーカー。USBコントローラーなど高速インターフェース向けの半導体設計に強み。
5	荏原製作所	資本財・サービス	日本	3.6%	流体(液体や気体)の制御ソリューションを提供する産業機械メーカー。半導体製造の分野にむけて平坦化技術(CMP装置)や真空技術(真空ポンプ)を手掛ける。
6	SKハイニックス	情報技術	韓国	3.4%	韓国のメモリメーカー。DRAM、NANDフラッシュメモリ、SRAMチップなどを製造。
7	ルネサスエレクトロニクス	情報技術	日本	3.2%	日本の半導体メーカー。自動車や産業向けのパワー・アナログ半導体を中心に幅広い半導体製品を手掛ける。
8	MARUWA	情報技術	日本	3.1%	セラミック部品を製造する日本企業。半導体分野で活用される製品を手掛ける。
9	KOKUSAI ELECTRIC	情報技術	日本	3.1%	日本の半導体製造装置メーカー。半導体製造の前工程における成膜プロセスや膜質改善プロセスに強み。
10	ディスコ	情報技術	日本	3.0%	日本の半導体製造装置メーカー。「切る(ダイサ)」「削る(グラインダ)」「磨く(ポリッシャー)」という3つの加工技術に強み。

※比率は、「Next Generation Semiconductor Asia Fund(円建て、ヘッジなしクラス)」の純資産総額に対する比率です。
※比率は小数点第2位を四捨五入しています。
※ニューバーガー・バーマンのデータを基にSBI岡三アセットマネジメントが作成しております。

アジア半導体関連フォーカスファンド　愛称　ライジング・セミコン・アジア
追加型投信／内外／株式

ファンドマネージャーのコメント

※当ファンドが高位に組入れております「Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）」のファンドマネージャーコメントを基に作成しています。

＜投資環境＞

2月のアジア株式市場は横ばい圏で推移しました。トランプ政権による関税導入を巡る話題が市場の焦点となりました。米政府は、カナダとメキシコ向けの関税について当初予定よりも導入を延期したものの、3月初旬には関税を発動する方針を改めて示しました。また、中国向け輸入製品には10%の関税が発効され、さらに追加で10%の追加関税を課す方針が示されました。企業決算においては、人工知能（AI）ブームの牽引役であった米エヌビディアが決算を発表し、業績は引き続き好調ではあったものの成長ペースが鈍化しているとの見方が強まりました。一方で、中国では習国家主席が民営IT大手の幹部と会談を行うなど、政府が大手IT企業を支援する姿勢を示しました。新興AI企業が低コストで大規模言語モデルを開発したと主張したこともあり、事業環境や技術開発に対する株式市場の再評価が進みました。日本では米国の関税政策に対する懸念や円高の進行を背景に、株式市場は下落しました。日本で金利の先高観が強まったなか、日米金利差が縮小したことなどから為替市場では円高ドル安が進みました。

＜運用経過＞

2月の基準価額は下落しました。アジアの半導体産業の中長期的な拡大から業績面で恩恵を受けることが期待できる銘柄に積極的な投資を実施してきましたが、台湾や日本の半導体関連企業の株価が下落したことなどが背景です。

個別銘柄では、X線計測装置を手掛ける日本の「リガク・ホールディングス」（情報技術）が上昇し、プラス寄与しました。2024年12月期本決算が実績、会社計画ともに良好だったことなどが背景です。一方、半導体製造装置を手掛ける日本の「ディスコ」（情報技術）が下落し、マイナスに影響しました。米エヌビディアの株価が決算後に下落したことなどを受けて、売りに押される展開となりました。

＜今後の運用方針＞

米国がカナダ・メキシコからの輸入品に関税を賦課し、中国への関税率を引き上げる措置に踏み切ったことで、「貿易戦争」への懸念が強まっています。一方で、こうした政策面の不確実性の高まりを受け、米国では企業景況感の減速や消費者センチメントの鈍化が顕著になっています。バイデン前政権による経済運営への不満がトランプ大統領の返り咲きの原動力だったこともあり、最終的には経済の腰折れ回避が優先されると見ていますが、当面は弱めの経済指標や株安がトランプ政権に方針転換を迫る「催促相場」の様相を呈する可能性があります。また、これまで株式市場の上昇を牽引してきた大手ハイテク企業の株価が軟化していることも見逃せない動きです。年初から欧州株式や中国株式が相対的に堅調に推移しており、米国大手ハイテク企業に集中していた資金がローテーションを開始している様子が見て取れます。マクロ経済環境の不透明感が強まる中、企業の「質」が株価の優勝劣敗を左右するものと考えます。

社会生活や産業活動のあらゆる場面で進展するデジタル化を支える半導体産業において、アジアはその製造・組立において重要な役割を担っており、魅力的な投資機会が豊富に存在すると考えています。引き続き、徹底したボトムアップ・リサーチを通じて、半導体産業の拡大に伴い業績成長が期待できるアジア企業を選定し、バリュエーションにも注意を払った運用を実施して参ります。

※ 今後の運用方針等は、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。また、市場環境等についての評価、分析等は、将来の運用成果を保証するものではありません。

アジア半導体関連フォーカスファンド　愛称　ライジング・セミコン・アジア
追加型投信／内外／株式

ファンド情報

設 定 日	2024年7月17日
償 還 日	2045年7月14日
決 算 日	毎年1月17日および7月17日（休業日の場合は翌営業日）

ファンドの特色

1 以下の投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業※の株式（これに準ずるものを含みます。）に投資します。

※アジア半導体関連企業とは、半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業をいいます。

- Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）
  <運用会社>ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー
- マネー・リクイディティ・マザーファンド

2 ポートフォリオの構築にあたっては、アジア半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析等を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定します。

3 Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）の組入比率は、高位を保つことを基本とします。

4 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

●分配方針

年2回、1月および7月の各月の17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。

- 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。繰越分を含めた経費控除後の配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。
- 分配金額は、分配対象収益の範囲内で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。

※委託会社の判断により、収益分配を行わないことがあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

基準価額の変動要因

投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
ファンドは、国内外の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。

●主な変動要因

株価変動リスク
株式の価格は、発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

為替変動リスク
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対する円高により、外貨建資産の円換算額は減少し、円安により、外貨建資産の円換算額は増加します。

特定の業種・テーマへの集中投資に係るリスク
ファンドは、特定の業種・テーマに関連する企業の株式を組み入れます。そのため、市場全体の値動きと比較して、基準価額の変動が大きくなる可能性があります。

信用リスク
有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となることがあります。

流動性リスク
有価証券等の時価総額が小さく、または取引量が少ないとき、市況の急変、取引所の閉鎖等により、有価証券等の売買価格が通常よりも著しく不利な価格となることがあります。

●その他の変動要因

カントリーリスク

※基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

投資リスク(2)

その他の留意点

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額 （当初申込期間中は、1口当たり1円です。）
購入代金	販売会社の定める期日までにお支払い下さい。 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。
換金単位	販売会社が定める単位 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金	換金申込受付日から起算して、原則として7営業日目から販売会社を通じてお支払いします。
申込締切時間	原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。 ※2024年11月5日以降は原則として、購入・換金の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
換金制限	ありません。
購入・換金申込不可日	以下に該当する日は、購入・換金申込の受付を行いません。 ・ニューヨークの銀行休業日 ・ニューヨークもしくは香港の取引所の休業日
購入・換金申込受付の中止及び取消し	投資対象とする投資信託証券にかかる購入・換金申込の受付の中止および取消、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込の受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込の受付を取消すことがあります。
信託期間	2045年7月14日まで（2024年7月17日設定） ただし、投資者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。
繰上償還	投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となることがあります。
決算日	毎年1月17日および7月17日（休業日の場合は翌営業日） *初回決算日は2025年1月17日です。
収益分配	年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。
信託金の限度額	1,000億円
公告	原則として、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 https://www.sbiokasan-am.co.jp
運用報告書	毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用				
購入時手数料	購入金額（購入価額×購入口数）に、販売会社が独自に定める購入時手数料率を乗じて得た額 **購入時手数料率の上限は、3.3%（税抜3.0%）です。** 購入時手数料率は変更となる場合があります。 詳しくは販売会社にご確認下さい。			ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われます。
信託財産留保額	**1口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3%**			
投資者が信託財産で間接的に負担する費用				
運用管理費用（信託報酬）	ファンド	**純資産総額×年率1.2925%（税抜1.175%）**		
		配分	委託会社	年率0.35%（税抜）	委託した資金の運用の対価です。
			販売会社	年率0.80%（税抜）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
			受託会社	年率0.025%（税抜）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
	投資対象とする投資信託証券	Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス） 純資産総額×年率0.65%		
	実質的な負担	**純資産総額×年率1.9425%程度** 実質的な負担とは、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた報酬です。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。		
その他費用・手数料	監査費用：純資産総額×年率0.0132%（税抜0.012%） 有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産でご負担いただきます。また、投資対象とする投資信託証券に係る前記の費用等、海外における資産の保管等に要する費用等を間接的にご負担いただきます。 ※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。			

※運用管理費用（信託報酬）、監査費用は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。その他費用・手数料（監査費用を除きます。）はその都度、投資信託財産から支払われます。

※ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。

委託会社および関係法人の概況

委　託　会　社　SBI岡三アセットマネジメント株式会社　（ファンドの運用の指図を行います。）

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第370号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

受　託　会　社　三井住友信託銀行株式会社　（ファンドの財産の保管及び管理を行います。）

アジア半導体関連フォーカスファンド　愛称　ライジング・セミコン・アジア
追加型投信／内外／株式

販売会社について

受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売会社には取次証券会社が含まれる場合があります。

商号	登録番号	加入協会			
		日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
(金融商品取引業者)					
岡三証券株式会社	関東財務局長(金商)第53号	○	○	○	○
岡三にいがた証券株式会社	関東財務局長(金商)第169号	○			
FFG証券株式会社	福岡財務支局長(金商)第5号	○			○
三縁証券株式会社	東海財務局長(金商)第22号	○			
株式会社証券ジャパン	関東財務局長(金商)第170号	○	○		
三晃証券株式会社	関東財務局長(金商)第72号	○			
野畑証券株式会社	東海財務局長(金商)第18号	○			○

委託会社
お問合わせ先

電話番号
03-3516-1300(営業日の9:00～17:00)

ホームページ
https://www.sbiokasan-am.co.jp

ご注意

- 本資料はSBI岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。購入の申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いします。投資信託説明書(交付目論見書)の交付場所につきましては「販売会社について」でご確認ください。
- 本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- 本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針通りの運用が行われない場合もあります。
- 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。